



日刊工業新聞

Business & Technology

超モノづくり部品大賞

第2部

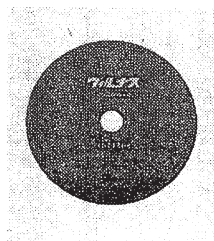
2009年(平成21年)
10月30日(金曜日)

(第3種郵便物認可)

結合剤部分傾斜型レジノイド切断砥石

平和テクニカ

平和テクニカ(東京都中央区)の「結合剤部分傾斜型レジノイド切断砥石」は、円盤状の砥石の両側面に樹脂を熱処理し装着することで、硬質で脆い材料の高精度、高効率な切断を可能にした。従来の砥石は連続切断すると砥石先端の形状が凸型のかまぼこ状になり



真つすぐ切れなかつた。また近年、半導体産業で使われる硬質脆性材の切断では欠けや部分割れが生じるという課題があった。そこで砥石の両側面

に、ボンドのフェノール系樹脂と同等成分の薄膜を熱処理、強化。砥石先端の形状が凹型になることで、切れ味を落とさず真つすぐ切れるようにした。また、砥石側面の気孔が減り、切断用冷却水が浸入しにくいため、砥石の変質を防げる。同社従来の品と比べて、切断表面の

両側面に薄膜処理

面粗度Raを10倍、平坦度を100倍近くまで向上させた。

喜びの声

わが提案強化

平和テクニカ社長

小池 達夫氏

お客様の「困った」お声を聞き、砥石の欠点をカバーしたのが同製品。お客様に課題をいただけではできなかった。その製品で賞をいただき、大変喜んでいますが、私自身、会社全体を良くしていく自覚と責任感もより強まった。受賞はうれしいが、お客様に喜んでいただくことが一番大事。これを励みに、顧客への提案を強化します。昨年のリーマンショック以降、既存顧客の分野が落ち込んでいます。受賞により、新市場開拓に向けてキックオフの機会を得ました。今後「切ることはモノづくりの第一歩」という考えのもとに、新素材への挑戦を続けていきたい。